

尖點科技董事會於今 (14) 日上午通過 2026 年第二季度財務報告，並於下午召開法人說明會。受惠於全球 AI 伺服器與高效能運算 (HPC) 市場需求持續成長，加上新產能逐步開出及高階產品比重提升，公司第二季營運規模與獲利能力同步提升，整體營運延續穩健成長態勢。

2026 年第二季合併營收為 18.26 億元，較上季增加 36.3%，較 2025 年同期增加 80.3%；營業毛利為 7.63 億元，較上季增加 55.7%，較 2025 年同期增加 155.9%，毛利率為 41.8%，較上季增加 5.2 個百分點，較 2025 年同期增加 12.4 個百分點；營業利益為 5.13 億元，季增 90.2%，年增 264.0%；歸屬於母公司業主淨利為 3.02 億元，季增 79.1%，年增 285.5%；每股盈餘 (EPS) 為新台幣 2.08 元。

累計 2026 年上半年合併營收為 31.66 億元，較 2025 年同期增加 66.6%；歸屬於母公司業主淨利為新台幣 4.71 億元，較 2025 年同期增加 261.4%；每股盈餘 (EPS) 為新台幣 3.25 元。

在本季營運成果中，受惠於 AI 伺服器與高效能運算需求持續強勁，加上產品結構優化，高階鍍膜鑽針產品比重於上半年提升至 56%，提前超越原設定全年平均 55% 的目標。隨著高附加價值產品比重提升及營運效率改善，本季營業利益率由上季 20.1% 提升至 28.1%，營運規模與獲利能力同步成長。

因應市場需求成長及中長期產能布局，尖點科技董事會於今 (14) 日上午亦通過辦理 115 年度現金增資暨國內無擔保轉換公司債，預計募集資金合計新台幣 16.8 億元，將主要用於廠房設施、機器設備及員工宿舍等相關投資，以充實營運成長所需資源，支應公司持續擴產及中長期發展。

展望後續，主要客戶持續擴充產能，AI 伺服器、高效能運算及高速通訊等應用需求維持正向。尖點科技的鑽針月產能自 4 月起由 3,500 萬支逐步提升，預計 2026 年底達 4,500 萬支；公司著眼長期成長，已啟動跨年度產能與技術布局，台灣中壢新廠與上海新廠按計畫推進中，規劃 2027 年底月產能達 7,000 萬支、2028 年底達 9,000 萬支，以支應中長期高階市場需求。鑽孔服務亦配合 AI 伺服器及高階 PCB 客戶需求持續擴充，強化「鑽針 + 鑽孔服務」雙軸布局。

隨著 AI 及高階運算帶動 PCB 層數、厚度與材料規格持續升級，尖點科技將持續投入高縱橫比鑽孔、高性能鍍膜等高階技術，提升高附加價值產品比重。隨新增產能逐步到位及產品組合持續優化，公司將掌握 AI 與高階 PCB 市場成長機會，持續強化長期競爭力。

投資人關係聯絡資料

張家齊 Allen Chang

E-mail: chang_chang@topoint.tw

Tel +886 2 2680 5868 Ext.868

Fax +886 2 2680 7588 Ext.868